

引領 AI 與儲存技術新浪潮

群聯於 COMPUTEX 全方位展出次世代高效能解決方案

2025 年 COMPUTEX 以「Connecting AI」為主題，聚焦生成式 AI、先進運算、綠色永續、未來通訊、智慧應用與創新等六大趨勢，匯聚全球科技巨擘展示 AI 時代關鍵應用。全球儲存與控制晶片領導廠商群聯電子（Phison Electronics Corp.，8299.TW）今年以「創新落地、部署未來」為主軸，於南港展覽館 1 館 4 樓 M0419a 攤位盛大展出多項突破性產品，從企業級 SSD、AI 應用解決方案，到高階消費性儲存控制晶片及 PCIe 高速傳輸 IC，全面對接 COMPUTEX 主題，展現推動 AI 普及與基礎架構革新的實力。



強效儲存迎戰 AI 大數據：企業級 SSD Pascari X200Z

面對生成式 AI 與即時分析帶來的龐大寫入負載挑戰，[群聯發表旗艦級企業 SSD——Pascari X200Z](#)。此款採用 PCIe Gen5 NVMe 架構、具備類 SCM 級(Storage Class Memory)低延遲回應，支援最高 60 DWPD 的極致耐寫能力。特別為 AI 訓練、大型交易資料庫與即時記錄系統打造，X200Z 提供無瓶頸的擴充性與穩定寫入效能，堪稱下一代企業儲存的標竿之作。

AI 應用落地利器：aiDAPTIVGPT 全方位推論工具包

隨著越來越多企業採用私有化訓練的大型語言模型 (LLM)，群聯同步推出全新 AI 應用服務套件——aiDAPTIVGPT。作為[獲得 Computex Best Choice Award](#) 的獨家專利平台

[aiDAPTIV+](#)的延伸應用，aiDAPTIVGPT 專為私有化訓練模型設計，提供文字對話、語音服務、程式碼生成、網頁搜尋與資料分析等推論功能，協助中小企業、教育機構與政府部門快速從內部資料中擷取價值，解決以往推論工具分散、難以整合的痛點。透過 aiDAPTIVGPT，企業可在保障資料隱私與安全的前提下，享有媲美雲端服務的生成式 AI 能力，為 AI 導入提供一站式解決方案，充分展現群聯在 AI 邊緣運算與私有化 AI 平台的技術領先地位。

此外，群聯電子也將在 Computex 展示其 aiDAPTIVCache 新一代專門為了 AI 邊緣系統而生的方案 AI150EJ，可以透過與群聯電子獨家開發的 aiDAPTIVLink 軟體層整合，優化推論響應時間(Time to First Token, TTFT)與增加可處理的 token 數目，來大幅提升 AI 邊緣運算系統的整體推論效能

全球首款 AI 運算 SSD：E28 PCIe Gen5 控制晶片再創巔峰

在高效能運算與電競應用領域，群聯以 E28 PCIe 5.0 SSD 控制晶片持續突破技術極限。E28 採用台積電 6nm 製程，是全球首款內建 AI 運算能力的 SSD 控制晶片，可加速 AI 模型更新與系統整體運作效能，開啟儲存裝置智慧化新紀元。

E28 在效能表現上亦創下新高，隨機存取效能可達 2,600K/3,000K IOPS（讀取/寫入），比同級距競品的資料處理能力高出 10%以上，充分展現群聯在高效能儲存領域的實力。此外，E28 的功耗表現亦領先業界，與相同採用 6nm 製程的競品相比，可降低 15%的功耗，同時兼顧能源效率與高效能。整體而言，E28 在資料頻寬與功耗之間達成完美平衡，使綜合效能功耗比（Performance/Power-Consumption）較同級 6nm 的競品提升達 15%至 30%，為高效能儲存裝置立下新標竿。

值得一提的是，E28 於開發階段即展現高度成熟度，首版設計即一次到位、成功量產，代表群聯擁有紮實的 IC 設計能力與豐富的量產經驗，亦間接凸顯同業面臨品質不穩與進度延遲的困境。

此外，[E28 也榮獲 COMPUTEX 2025 Best Choice Award 最高榮譽金獎（Golden Award）](#)肯定，代表其在創新性、實用性與市場潛力方面全面領先，是未來旗艦級 SSD 的關鍵核心。

行動平台首選：E31T DRAM-less Gen5 控制晶片進化登場

針對輕薄筆電與掌上型遊戲機等對體積與功耗高度敏感的應用需求，[群聯推出全新 E31T PCIe 5.0 DRAM-less 控制晶片](#)，現支援 M.2 2230 與 2242 等迷你規格。E31T 具備小尺寸、高效能與低功耗三大特點，為行動平台提供高性價比的儲存解決方案。

作為群聯在 DRAM-less 產品線的最新力作，E31T 延續 PCIe 5.0 速度優勢，同時兼顧成本與續航表現，是推動次世代行動裝置儲存效能升級的最佳選擇。

傳輸效率再進化：PCIe 高速訊號控制晶片領航全球

秉持高速傳輸專業，群聯進一步展出[完整 PCIe 高速訊號解決方案](#)。包括全球首款取得 CXL 2.0 認證的 PCIe 5.0 Retimer、擁有超過 50% 市佔率的 PCIe 5.0 Redriver，以及全球最早進入市場的 PCIe 6.0 Redriver。展場亦將展示新一代 PCIe 6.0 Retimer、Redriver、SerDes PHY 與與客戶合作開發的 PCIe over Optical Platform，彰顯群聯在 PCIe 高速訊號領域的領導地位與實績。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示：「AI 與儲存技術的融合正加速改變世界，群聯在今年 COMPUTEX 展示的，是我們為全球數位轉型所打造的關鍵引擎。從獲得金獎肯定的全球首款 AI SSD 控制晶片 E28、到企業級高速儲存 Pascari X200Z，再到推動私有化 AI 普及的 aiDAPTIVGPT 工具包，每一項創新都是群聯深耕研發、洞察未來所累積的成果。我們相信，AI 應用的普及不能只侷限在大型企業，未來的競爭力在於如何協助中小企業、教育單位與政府機構也能用得起、用得快、用得安全。群聯將持續秉持『創新落地、部屬未來』的精神，打造更高效能、更低功耗的儲存與 AI 解決方案，攜手全球產業夥伴，共同迎向 AI 驅動的新世代。」

誠摯邀請您親臨現場，體驗群聯獨家 AI 與儲存創新技術！

- 日期：2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 23 日（星期五）
- 時間：每日上午 9:30 至下午 5:30
- 地點：台北南港展覽館 1 館 4 樓
- 攤位編號：M0419a（群聯電子）

[群聯公告暨新聞稿訂閱]

如欲獲取群聯新聞稿或其它公告，請訂閱：[群聯投資人關係訊息訂閱](#)

[關於群聯的關鍵數字]

- 超過 25 年的 NAND 控制晶片暨 NAND 儲存方案整合經驗
- 全球超過 4000 位員工，且 70%以上為工程師
- 全球超過 2000 個 NAND 儲存相關專利
- 透過 5+5 長期發展大戰略，驅動長期千億級營收
- SSD 控制晶片全球市佔率超過 20%
- 車用控制晶片全球市佔率超過 40%
- 群聯與日本 KIOXIA、美光 Micron、威騰 WDC、三星、SK Hynix 等 NAND 原廠，均為長期合作夥伴。
- 超過 70%營收貢獻度來自於『非消費型』的 NAND 儲存應用市場，包含伺服器、車載系統、嵌入式系統、工控應用、電競主機、生成式 AI 等，讓群聯能在 NAND 產業的波動變化下，依舊能維持相對穩定的營收與獲利。
- 群聯對整體 NAND 產業生態鏈的掌握（包含從上游的 NAND 原廠的雙向合作關係、NAND 控制晶片與儲存模組的供應鏈夥伴、至下游的 NAND 儲存應用客戶等），是群聯所能帶給全球客戶與夥伴的不可取代價值，也是群聯能在 NAND 產業屹立不搖的關鍵優勢。

[關於群聯電子]

群聯電子 (Phison Electronics Corp.) 長期耕耘於快閃記憶體控制器晶片領域，是全球 NAND 儲存控制晶片 (NAND Controller) 及存儲解決方案 (NAND Storages) 領導廠商。從 IP 技術授權、晶片設計、系統架構解決方案、系統整合至成品，為不同需求的客戶提供最佳的產品與服務。在各項產品類別上，包括 SSD (PCIe/SATA/PATA)、UFS、eMMC、SD 與 USB 介面，皆可提供完整的存儲解決方案。

歡迎拜訪 [群聯網站](#) 或 [群聯 Q&A](#) 以更了解群聯電子。

群聯電子發言人

于紹庭 Antonio Yu

TEL: 037-586-896 #10019

Mobile: 0979-105-026

Email: antonioyu@phison.com

群聯電子代理發言人

呂國鼎 Kuo-Ting Lu

TEL: 037-586-896 #26022

Mobile: 0979-075-330

Email: kuoting_lu@phison.com

[預測性陳述聲明]

本新聞稿所提供之資訊(除歷史資訊之外)屬於預測性陳述。在此敬告讀者，預測性陳述乃基於群聯之合理認知以及就現狀所作的預估，且將受到各種風險以及不確定因素影響，因此可能造成實際結果和預測性陳述之內容顯著不同。這些風險以及不確定性因素包括但不限於，供給與需求變化、產銷能力、開發成功、及時導入市場、市場競爭、產業循環、客戶財務狀況、匯率浮動、法律訴訟、法令變更、全球經濟變化、自然災害、其他可能會影響群聯業務與營運的不確定因素。鑑於此，讀者請勿倚賴預測性陳述。除法律另有規定外，無論是基於新資訊、未來事件或是其他因素，群聯皆無義務更新預測性陳述。